



李长荣科技股份有限公司
LCY TECHNOLOGY CORP.

2019/12

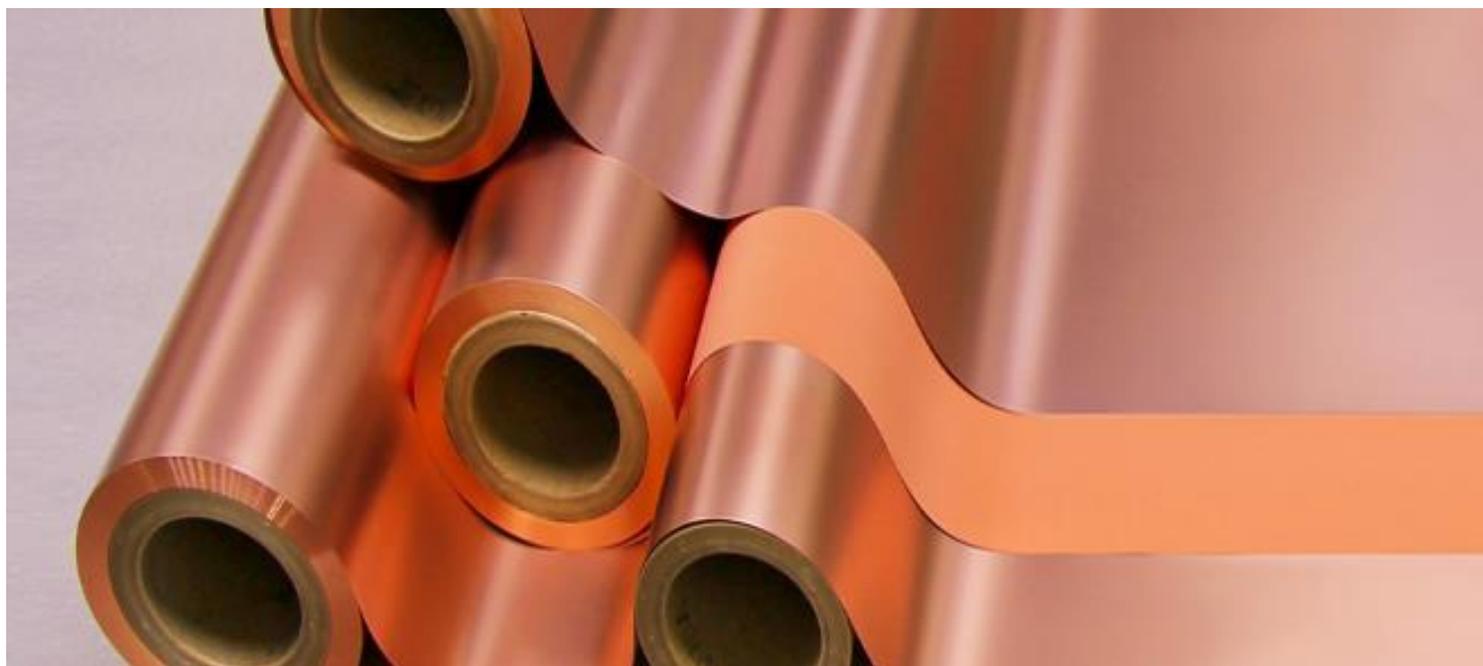
Differentiation · Innovation · Green

免责声明

- 本简报合并财报数字系根据国际财务报导准则编制，并经由会计师核阅。
- 本简报中可能包含对产业及前景之预测，系基于对现况之预期，但可能同时受限于已知或未知风险与不确定性影响。因此实际结果将可能明显不同于所陈述之内容。
- 除法令要求外，本公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生，主动更新对未来展望的表述。
- 本简报数据不得视为买卖有价证券或其他金融商品之要约或要约之引诱。
- 本简报数据之著作权归本公司及本公司关系企业所有，不得直接或间接复制或传送给任何第三人，且不得为任何目的出版刊印。

大纲

1. 公司简介
2. 产业概况
3. 产品及市场
4. 营运绩效
5. 经营理念及未来展望
6. Q & A



公司简介

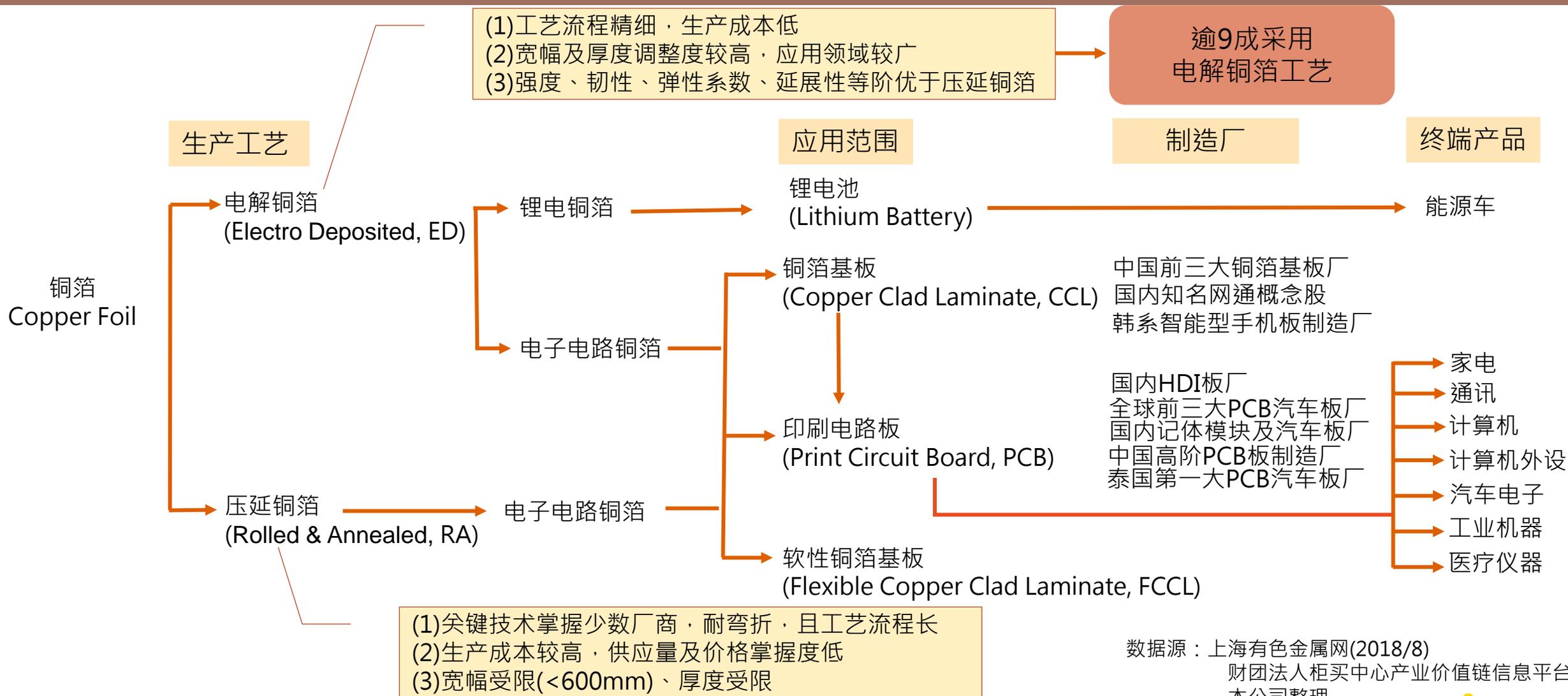
基本数据

- 成立日期：1997年1月16日
- 董事长兼执行长：王守仁
- 总经理：陈铭树
- 股票上市挂牌日：2018年6月28日
- 实收资本额：新台币1,530,850仟元
- 营业项目：电解铜箔之设计、制造及销售

公司沿革

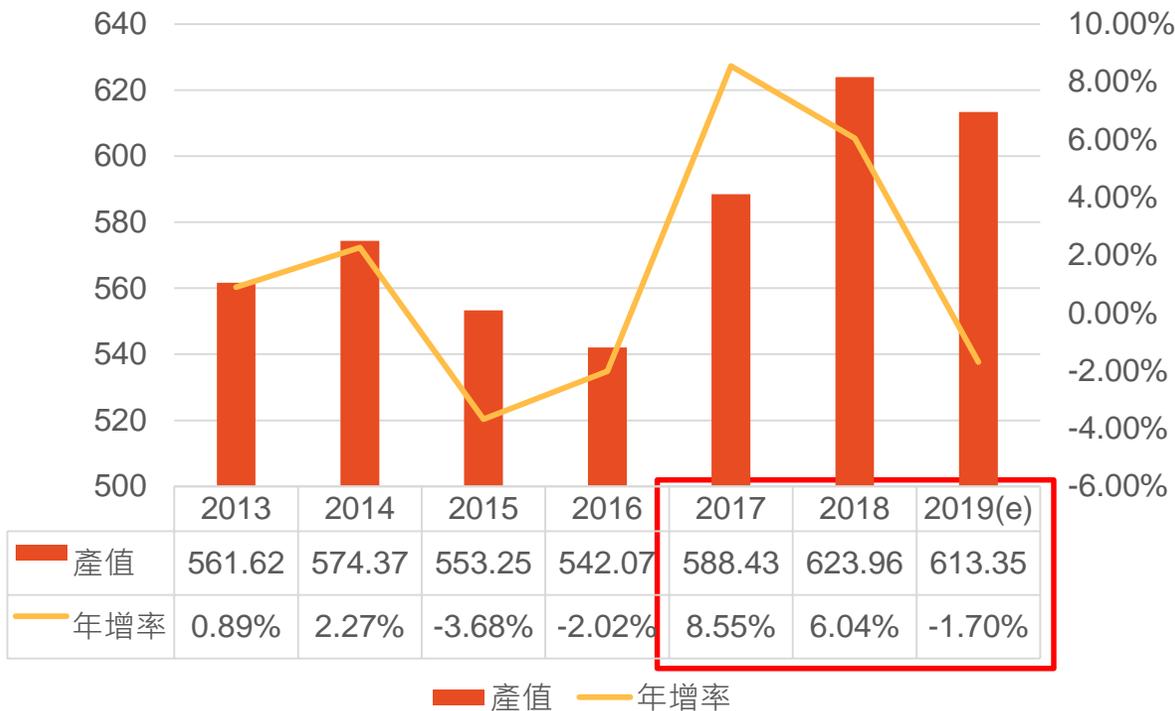
- 2019 VLP产线(ED#30)预计将于年底前完工
- 2018 KKR收购母公司荣化，荣科成为KKR间接持股之关系企业
股票挂牌上市，资本额 NT 1,530,850仟元
扩建VLP产线(ED#30)动工
- 2017 股票公开发行暨登录兴柜
- 2007 工厂扩建完工，年产量：10000吨
- 2000 工厂完工试车，年产量：5000吨
- 1997 李长荣科技股份有限公司成立，资本额 NT 200,000仟元

产业概况



产品及市场

全球PCB产值 单位：亿美元

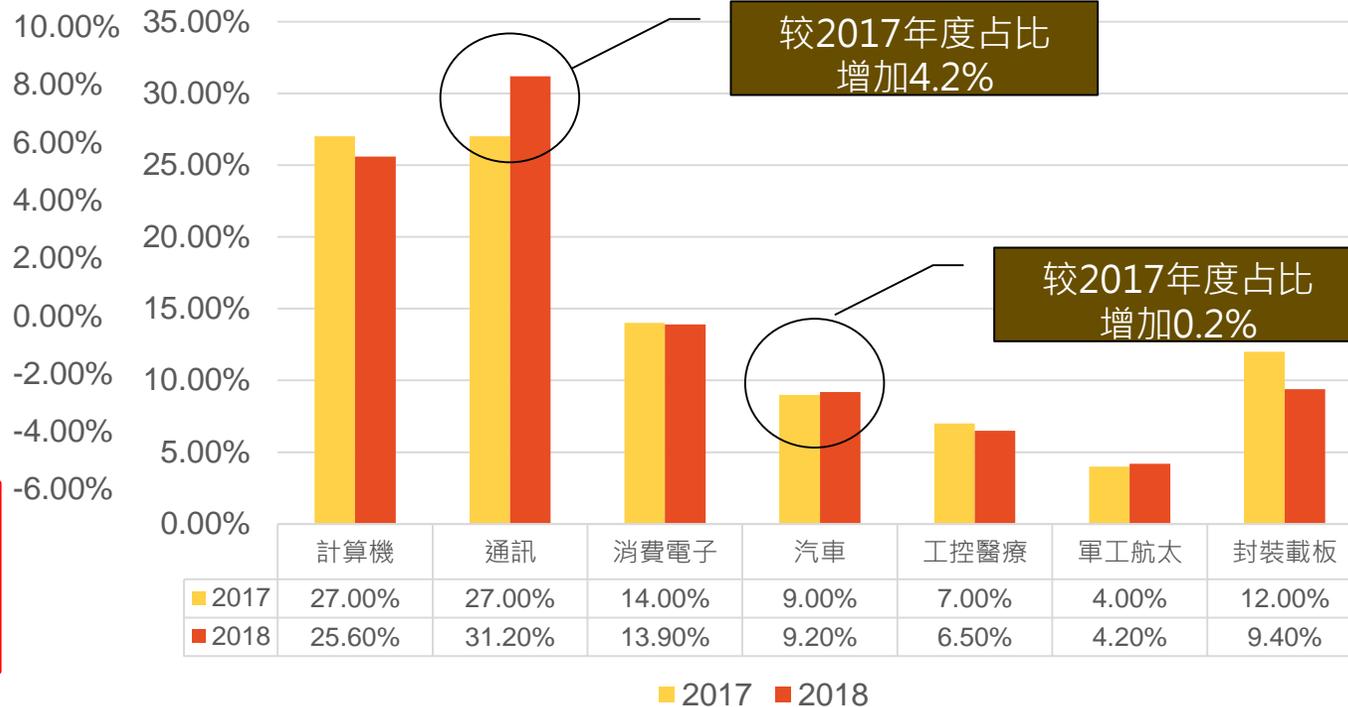


2017年度：
汽车电子、消费电子、通讯设备开创PCB产业的新周期

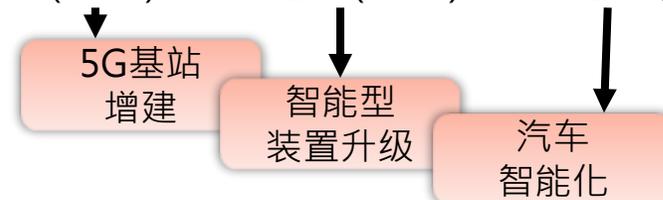
2018年度：
5G世代、智慧手机升级、互联网兴起，及汽车电子复杂度的提升

2019年度：
网通、基地台需求升温，但智能型手机需求疲弱+美中贸易不确定性

PCB 下游应用领域占比变化



研究机构预测：2018年~2022年下游应用领域对PCB CAGR的贡献将主要集中在 **通讯 (3.5%)**、**消费电子 (4.2%)**、**汽车电子 (3.9%)**

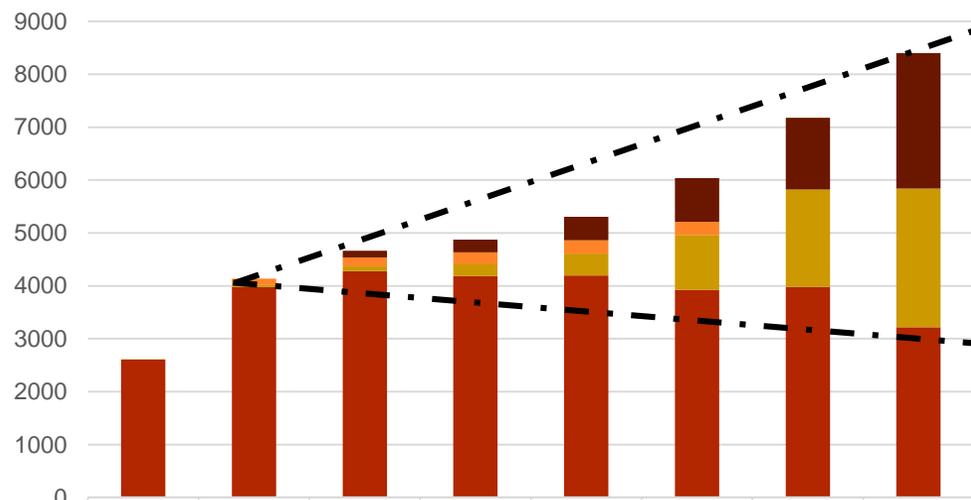


产品及市场

需求

5G网通基础建设

全球新建/升级之小型基地台市场趋势 单位：千台



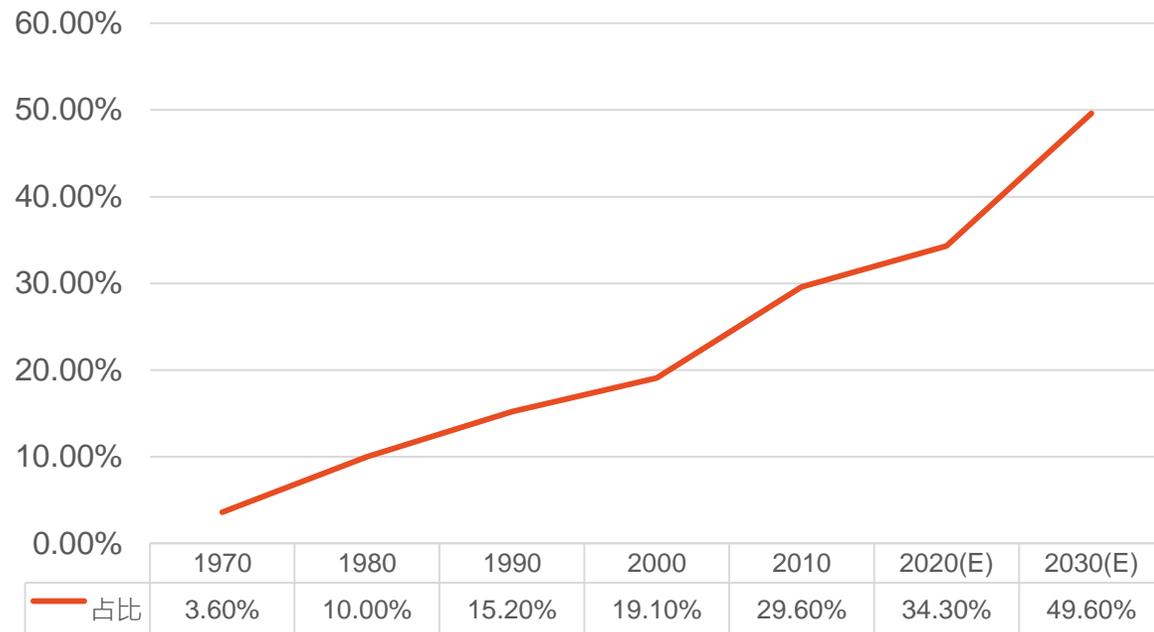
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5G NR standalone	0	0	125	241	443	829	1353	2562
5G NR Non-Standalone	0	118	167	227	249	245	0	0
5G/4G combined BTS	2	34	92	222	416	1035	1843	2621
LTE or 3G/4G	2604	3982	4279	4185	4197	3928	3982	3220

■ LTE or 3G/4G ■ 5G/4G combined BTS ■ 5G NR Non-Standalone ■ 5G NR standalone

数据源：SCF、资策会MIC，2019/7

车载电子+动力及安全系统

汽车电子占整车成本比重



受惠于5G的高速传输速率，低延时特性，加速车联网及自动驾驶，未来汽车电子化程度将大大提升

数据源：Prismark、中国产业信息网，2019/8

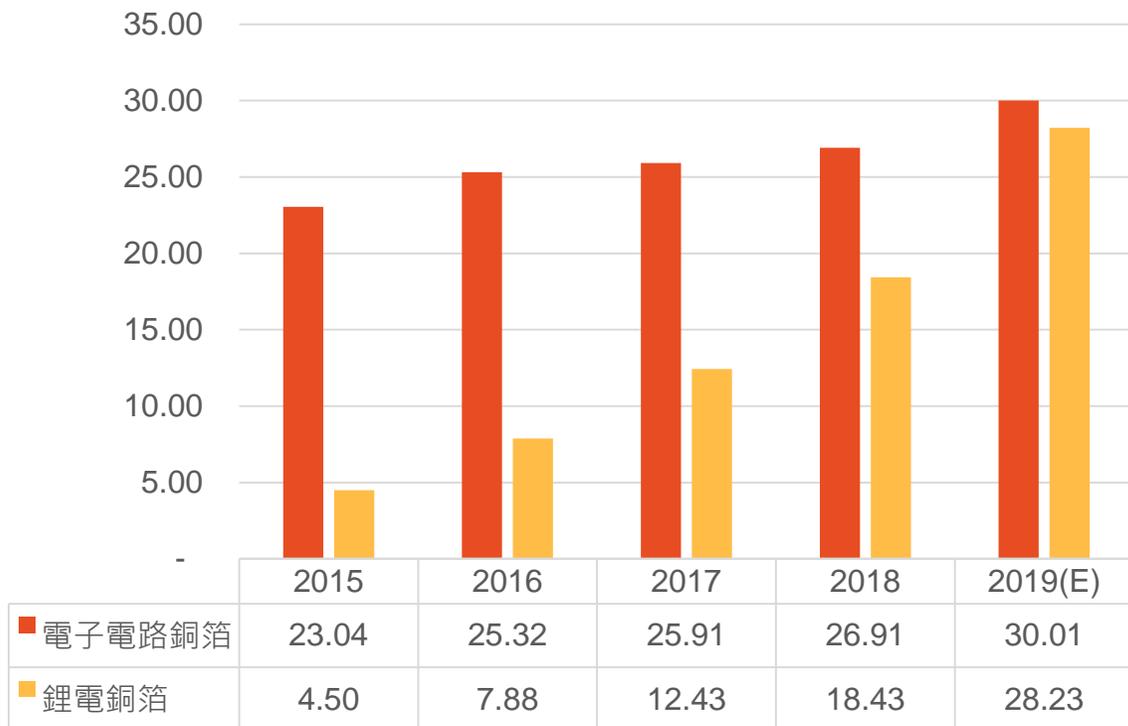
产品及市场

供给

电解铜箔产能

铜箔产能

单位：万吨



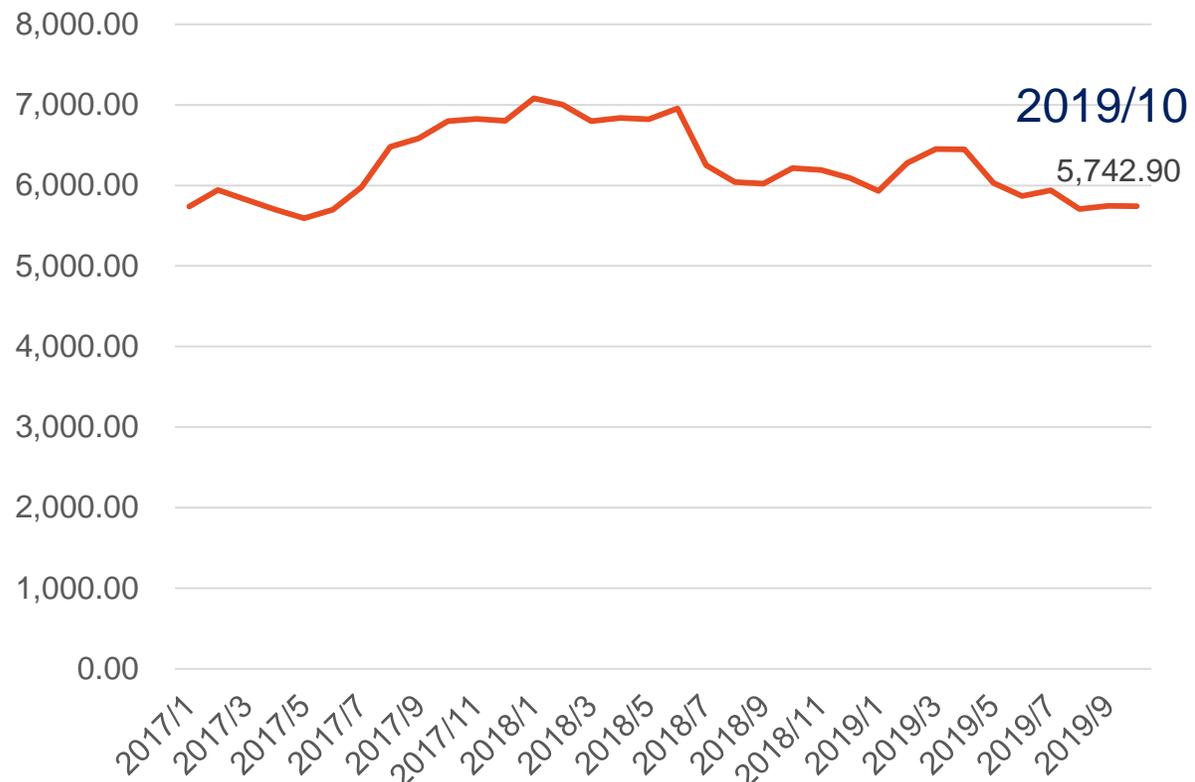
■ 電子電路銅箔 ■ 鋰電銅箔

数据源：TPCA协会

LME铜价走势

LME铜价走势

单位：美元



数据源：台湾区电线电缆工业同业公会、本公司整理

产品及市场

应用领域	电子电路铜箔项目
5G通讯、汽车电子	高频高速电解铜箔
半导体封装基板	9μm以下附载体铜箔
大功率、大电流 汽车厚铜基板	厚铜箔 (2oz~6oz)
手机	二层法电解铜箔
HDI多层板	HDI用电解铜箔

数据源：电子铜箔信息第41期·2018/8

主要产品

PK-HTE-LP3

主要特色	产品应用
符合IPC-4562A Grade 3之毛面瘤化处理箔	可用于一般Tg、Hi-Tg、无卤基板等基材，单面、双面、多层板均可用
毛面经粉红色抗热层处理	

PK-HTE-RTF

主要特色	产品应用
符合IPC-4562A Grade 3之反转瘤化处理箔	高频产品 内层薄板
均一瘤化镀层处理，胶片结合粗糙度较一般箔低	

BR-DSS-LX series

主要特色	产品应用
极低粗糙度的红棕色箔	高频产品 极细线路板
均一的次微瘤化镀层处理	

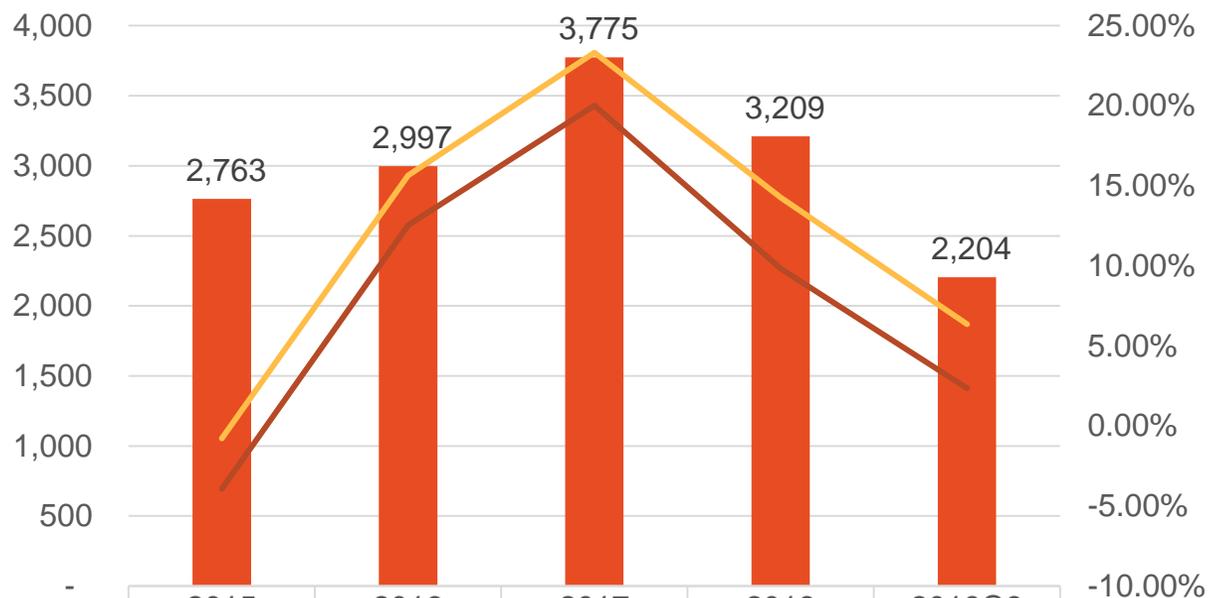
产销状况

产	工厂	全产全销 客制化配方调整 旧设备汰换
销	CCL客户	高阶板材需求持续强劲，订单交期稳定
销	PCB客户	HDI、Server板订单较上半年为优
销	汽车板客户	主要客户产能回复，需求较上半年提升

營運績效

單位：新台幣百萬元

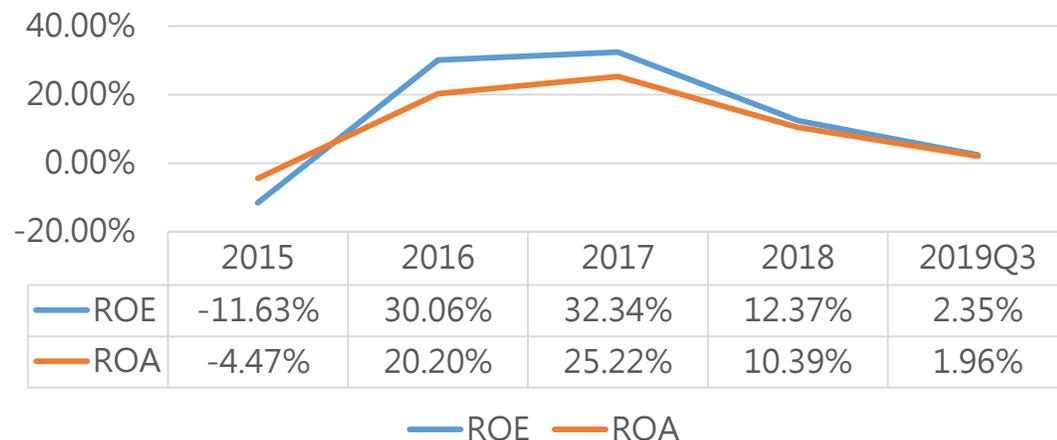
營收及獲利能力



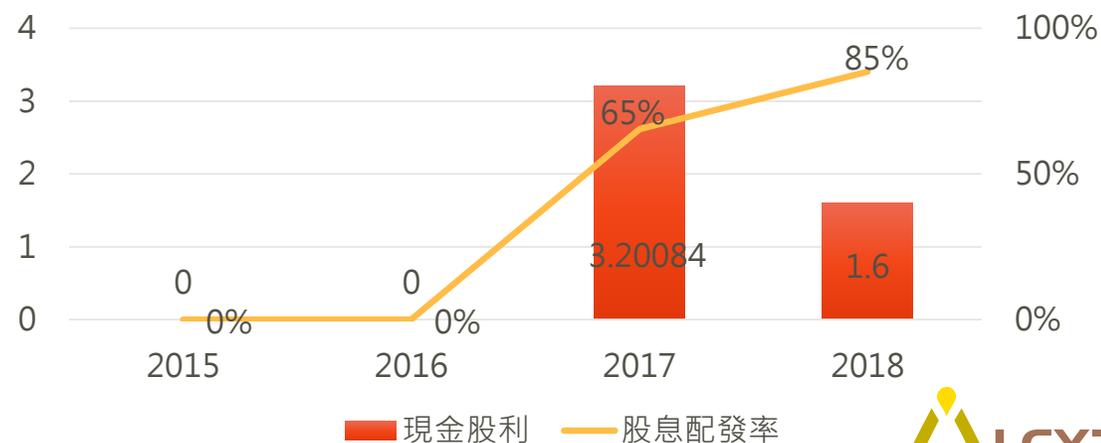
營業淨額	2,763	2,997	3,775	3,209	2,204
毛利率	-0.79%	15.65%	23.33%	14.26%	6.35%
營業淨利率	-3.93%	12.53%	20.01%	9.82%	2.36%

營業淨額 毛利率 營業淨利率

ROE/ROA



历年股利发放金额及发放比率



現金股利 股息配發率



经营理念及未来展望



研发端

因应终端数据需求市场：
(1)CCL：增加抗撕强度
(2)PCB：低介电常数(Low Dk)
低介电损失(Low Df)

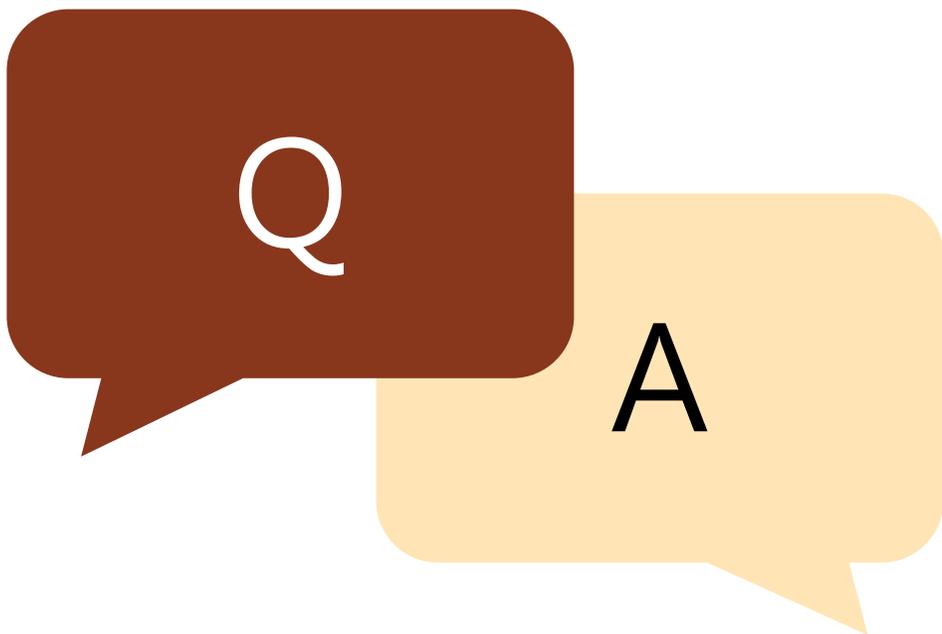
业务端

(1)特殊板卡用箔客户来厂稽核完成
(2)销售版图分散：中(70%)、泰(9%)、
台(12%)、欧(1%)

生产端

产线调度，持续放量：
(1)高稳定度、(2)高附加价值
(3)利基性产品

Q & A



- 发 言 人：陈铭树，Paul Chen
- 代理发言人：蔡孟修，Berry Tsai
- 联络电话：(02)2763-1611
- 联络信箱：lcyt@lcygroup.com
- 公司资讯：www.lcyt.com.tw



Thanks for your attention!

Differentiation · **I**nnovation · **G**reen